# 自立 GaN 基板上 GaN ホモエピ層の表面モフォロジーと基板オフ角

A surface morphology of a homo-epitaxial grown GaN on a freestanding GaN substrate

# <sup>0</sup>堀切 文正、成田 好伸、吉田 丈洋((株)サイオクス)

## <sup>°</sup>F. Horikiri, Y. Narita, T. Yoshida (Sciocs Co. Ltd.) E-mail: fumimasa-horikiri@ya.sumitomo-chem.co.jp

### <u>1. はじめに</u>

自立 GaN 基板を用いた縦型デバイスにおいて、①ドリフト層のドナー濃度<sup>[1]</sup>、②エピ膜厚<sup>[2]</sup>、 ③表面モフォロジーがデバイス特性に影響する。特に、表面モフォロジーは、荒れている場合に は逆方向リークに強く影響する事が報告されている<sup>[3]</sup>。エピ層の表面モフォロジーは、基板オフ 角やエピ成長条件等によって異なるが、偏微分方程式の解であり<sup>[4]</sup>、解析的なアプローチにより 理解する事は困難である。そのため、表面モフォロジーと基板オフ角の関係を実験的に明らかに する必要があった。今回、上記を議論するために必要な基板オフ角の数学的な記述と実験的に求 めた平坦なエピ表面が得られる基板オフ角の関係について報告する。

### <u>2.実験</u>

面内のオフ角分布の異なる4種類の直径2インチのn型自立GaN基板上に、MOVPE法により 厚さ13μm,Si濃度9x10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>のドリフト層を有するショットキー接合ダイオード構造(SBD)のエ ピ層を成長した。VAS法により作製したGaN基板においてはオフ角の値はウエハの位置おいて線 形に変化するため、用いたGaN基板のオフ角分布は式(1)および表1で近似する事ができる。

$$\begin{pmatrix} \theta_{off \parallel m} \\ \theta_{off \parallel a} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & M_2 \\ 0 & A_1 & A_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \gamma_{a-\operatorname{axis} \angle OF} & -\sin \gamma_{a-\operatorname{axis} \angle OF} & 0 \\ \sin \gamma_{a-\operatorname{axis} \angle OF} & \cos \gamma_{a-\operatorname{axis} \angle OF} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$
(1)

ただし、(*x*, *y*)はウエハ面内の座標、( $\theta_{off/m}$ ,  $\theta_{off/a}$ )はオフ角の *m* 軸成分および *a* 軸成分、( $M_1$ ,  $A_1$ )は オフ角の *m* 軸成分および *a* 軸成分の面内傾き、( $M_2$ ,  $A_2$ )はウエハ中心における *m* 軸成分および *a* 軸成分のオフ角の値である。なお、今回用いた GaN 基板は全て *a* 面オリフラで $\gamma = 0^\circ$ である。定 数  $M_1$ および  $A_1$ は、もし、ウエハスライス時の非対称性がなければ  $M_1=A_1$ となる。式(1)で示した

マトリクスにより、ウエハ面内の任意の点の基 板オフ角(m 軸成分 θ<sub>off/m</sub>, a 軸成分 θ<sub>off/a</sub>)が記述で きる。エピウエハの表面モフォロジーは、ノマ ルスキー顕微鏡により観察した画像を、2.25mm 角毎に目視で判定し、4 水準の粗さに区分けした。 代表的な点については、AFM 測定を行った。

#### 3. 結果

図1に示す様に面内のオフ角分布の異なる4種類 のGaN 基板を用いたSBD 構造のエピウエハ表面を 観察したところ、m軸方向に0.5°程度オフしたオフ 角を有するウエハ位置で、平坦な表面モフォロジー が得られる事が分かった。また、最適な基板オフ角 の範囲についても、式(1)を用いて3つのパラメータ のみで記述できる事が明らかとなった。

なお、本研究は環境省「未来のあるべき社会・ライ フスタイルを創造する技術イノベーション事業」の 委託を受けてなされた。

F. Horikiri et al., Jpn. J. Appl. Phys. 56, 061001 (2017).
F. Horikiri et al., Jpn. J. Appl. Phys. 56, 120301 (2017).
O. Aktas et al., CS MANTECH 2015, 301 (2015).
C. Misbah et al., Rev. Mod. Phys. 82, 981 (2010).

## Table I. GaN substrate specifications

	Off-angle matrix			
Specification	<i>M</i> <sub>1</sub> (°/mm)	<b>A</b> <sub>1</sub> (°/mm)	<i>M</i> <sub>2</sub> (°)	<b>A</b> <sub>2</sub> (°)
a-off	0.015	0.011	-0.03	0.41
<i>m</i> -off	0.014	0.015	0.64	0.02
just-off	0.009	0.010	0.01	0.11
<i>m</i> -off modified	0.003	0.005	0.43	0.03



Fig. 1 A surface morphology of the GaN-on-GaN wafers